

2025年9月5日

各位

公司名 尼得科精密检测科技株式会社
代表人 董事长 山崎 秀和
地 址 京都府日本京都府向日市森本町东之口 1-1
Nidec Park C 栋

尼得科精密检测技术将参展 SEMICON TAIWAN 2025

尼得科精密检测科技株式会社(以下简称“本公司”),将参展2025年9月10日(三)~9月12日(五)于中国台湾台北南港展览馆举办的“SEMICON TAIWAN 2025”。本次展会将展出半导体业界的前沿技术及革新技术,为亚洲最大规模的国际展会之一。



该展会为中国台湾颇具影响力的半导体产业活动,本年度以“Leading with Collaboration. Innovating with the World”为主题,预计有来自56个国家的1,100多家企业参展。

半导体产业在现今AI与高性能计算(HPC)需求激增的浪潮下,迎来了“超摩尔定律”时代。随着处理能力的增强,半导体相关产品呈现出更加细微化以及实装更加复杂化的发展趋势,而开发相应的新检测技术便成了当务之急。

本公司以“ONE STOP SOLUTIONS of AI server/EVs”为主题,在此次展会上除了介绍晶圆检测用治具“探针卡”的新型解决方案之外,还将介绍本公司引以为豪的光学检测技术、电气检测技术、探针检测技术。并针对先进半导体封装的晶圆、晶片、基板、封装全制程,提出高水平的检测方案。此外还会一并介绍最近备受关注的功率半导体检测装置及传送手臂相关的前沿技术及产品。

<参展概要>

- 展期: 2025年9月10日(三)~9月12日(五)
- 会场: 中国台湾台北南港展览馆(TaiNEX 1)
- 展位: Hall 11 K2786

〈参展内容〉

- 高精度、减少噪音影响的“2D MEMS 探针卡”
- 适用于-40℃~200℃环境检测的“TC 探针”
- 适用于最先进设备的、最小间距为 60 μm的“MEMS FLEX 探针卡”
- 适用于高电压、高温环境检测的“腔体头 (Chamber head) 式探针卡”
- 适用于高温、高电压、高密度环境检测的探针“3H+探针”
- 高精度光学式晶圆检测设备“NSW 系列”
- 适用于晶圆凸块的光学式 2D/3D 检测设备“RWi 系列”
- 适用于 TGV 的光学式 2D/3D 检测解决方案
- FOPLP/RDL 导通检测设备“GATS-7886”
- 功率半导体检测系统“NATS-1000 Series”
- EV 测试台“TDAS-Series”
- xEV 建模模拟器“E-Transport Simulator”
- Wafer 传送手臂系统“AVR SMV 3000” ※与尼得科仪器共同开发